課題番号 :F-18-KT-0142

利用形態:技術補助

利用課題名(日本語) :ダイヤモンドデバイスの作製、評価 その2

Program Title(English) : Evaluation of the diamond device, part 2

利用者名(日本語) :鹿田真一,小林勇介

Username(English) : S. Shikata, Y. Kobayashi

所属名(日本語) : 関西学院大学大学院理工学研究科 Affiliation(English) : Kwansei Gakuinn University

キーワード/Keyword :パワーデバイス、ダイヤモンド、分析

## 1. 概要(Summary)

近年、高度通信端末、IoT など通信の高度化に伴う高 周波化が目覚しい。中でも SAW デバイスは周波数選別 など通信に欠かせない機器であり、高周波化対応が必至 であるが微細線幅制御など、従来材料では限界に差し掛 かっている。ダイヤモンドは物質中最高位の弾性定数を 有し、高速 SAW 基板として 20 年前から研究・実用されて きた。[1]高 K<sup>2</sup> 材料の ScAlN 圧電薄膜[2]を用いた研究 が単結晶ダイヤモンド上で実施され優れた特性が確認さ れ、本研究では実用を勘案し、多結晶ダイヤモンド基板 を用いて SAW デバイスの試作・評価を行った。

# 2. 実験(Experimental)

## 【利用した主な装置】

高速高精度電子ビーム描画装置(A01)、厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置(A07)、電子線蒸着装置(B03)、ドライエッチング装置(B10)

#### 【実験方法】

スパッタリングによりダイヤモンド上に ScAlN 圧電薄膜を成膜し SAW 基板を作製した。京都大学ナノハブ拠点にて、高速高精度電子ビーム描画装置(A01)を利用した EBリソグラフィーにより SAW 基板上にL&S=0.5 μm, 0.8 um の微細レジストパターンを作製した。電子線蒸着装置を利用し、Al/Cr(厚さ:90 nm/5 nm)を蒸着させリフトオフにより SAW 電極パターンを作製した。(Fig.1)また作製した SAW デバイスの特性測定を行った。

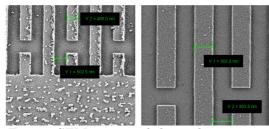


Fig. 1 SEM images of electrode patterns. (L&S=0.5 µm(left), 0.8 µm(right))

### 3. 結果と考察 (Results and Discussion)

作製したデバイスの周波数特性測定を  $2.2~{
m GHz}$  周辺 および、 $3.5~{
m GHz}$  周辺で行った。解析結果は、 ${
m Fig.}~2$  のようになった。単結晶ダイヤモンドを用いた研究では、 $3.6~{
m GHz}$  で共振  ${
m Q=520}$ 、反共振  ${
m Q=130}$  であり、今回 の試作デバイスはこれよりも小さかったが、 $2.2~{
m GHz}$  および  $3.5~{
m GHz}$  周辺において高い電気機械結合係数  ${
m K}^2$  が確認できた。

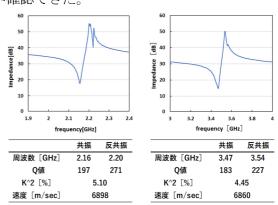


Fig. 2 Impedance characteristics of the 2.2 GHz and 3.5 GHz one port SAW resonators.

# 4. その他・特記事項(Others)

#### •謝辞

本研究の一部は、村田学術振興財団の研究助成によるもので、深謝致します。

#### •参考文献

- [1] 鹿田真一、弾性波デバイス技術(2004)オーム社
- [2] 藤井、佐藤、大森、橋本、梅沢、鹿田、勅使河原、加納、電子情報通信学会、J96-A (2013) pp.351-356
- 5. 論文·学会発表 (Publication/Presentation)

"ScAlN/多結晶ダイヤモンド SAW 共振子の作製・評価"、小林 勇介, 麻尾 裕己, 橋本 研也, 鹿田 真一第66回応用物理学会 春季学術講演会. 2019年3月9日(土) ~ 12日(火)東京工業大学大岡山。

# 6. 関連特許(Patent)

なし。